



第十六届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2015)

尊敬的_____先生/女士，您好！

第十六届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2015) 将于2015年08月在长沙召开。

会议通知

第十六届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2015) 将于2015年8月11日至14日 在湖南长沙举行。



The 16th International Conference on
Electronic Packaging Technology (ICEPT 2015)

第十六届电子封装技术国际会议



August 11-14th, 2015 Changsha, China
2015年8月11-14日 中国 长沙

(第十六届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2015))

会议主题可参见2014年电子封装技术国际会议 (ICEPT 2014) 会议主题

先进封装：焊球阵列封装、芯片级封装、倒装芯片封装；COB、WLP及其他各种先进的封装技术；POP/PIP等三维封装；先进封装基板技术。

系统级封装：包含TSV的三维封装；系统级封装技术；三维封装与系统级封装的测试技术。

封装材料与工艺：绿色材料、纳米材料和其它能够提高封装性能和降低成本的新型材料；以及与封装材料相关的工艺。

封装设计与模拟：各种新的封装/组装设计；电子封装的电、热、光和机械特性建模、仿真和验证方法；多尺度和多物理场建模；工艺过程仿真。

互连技术：高密度互连技术；先进键合技术；应用于三维集成的基板技术；非传统的互连技术。

封装制造技术与设备：封装和组装制造技术与设备；晶圆减薄技术与设备；在线测量与表征技术与设备；提高可制造性和良率的技术与设备；低成本和高可靠性制造技术与设备。

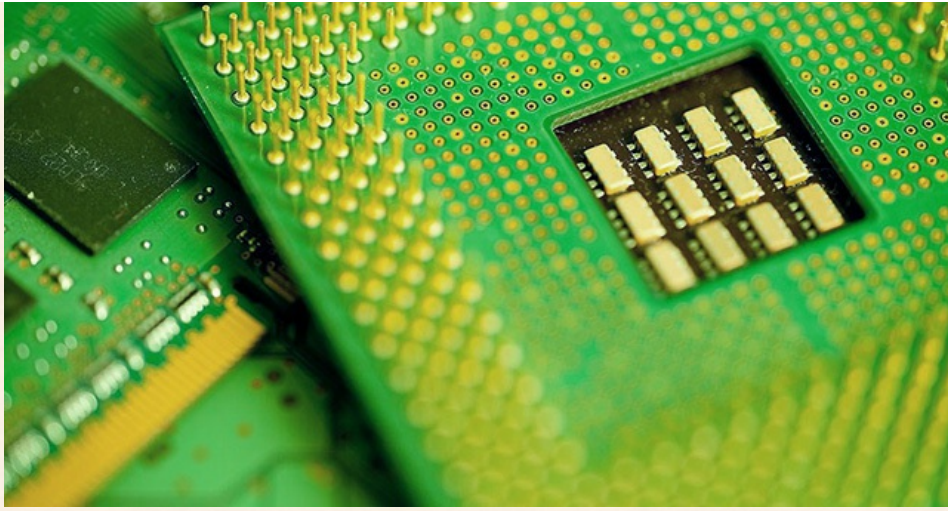
质量与可靠性：质量检测与评估；快速可靠性数据采集和分析方法；可靠性模拟和寿命预测；失效分析和无损检测等。

固态照明封装与集成：LED封装新技术；大功率LED模组的设计、制造和测试方法；LED封装及集成技术在显示器背投、微型投影仪、室内照明和街灯等方面的应用。

微波与功率器件封装：微波元件与组件；微波器件与封装；功率器件封装；汽车电子相关封装。

新兴领域封装：MEMS/NEMS封装、MOEMS封装；光电子封装；医用电子器件封装；可穿戴/柔性电子封装；传感器、执行器及纳米器件等新兴领域的应用。





(第十六届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2015))

大会组织

大会主席

毕克允 中国电子学会常务理事、中国电子学会电子制造与封装技术分会理事长、中国半导体行业协会封装分会理事长

大会共同主席

张尧学 中国工程院院士、中南大学校长

薛捷 美国思科系统公司研发总监部门总裁、IEEE-CPMT主席

张国旗 荷兰代尔夫特大学教授、飞利浦公司半导体照明高级总监

刘建影 上海大学教授、查尔姆斯理工大学教授、瑞典皇家工程院院士

樊学军 美国拉马尔大学教授

大会秘书

何虎 中南大学

陈相宇 中国电子学会电子制造与封装技术分会

会议门票

A类：2800人民币元/人（包含会议资料、8月12-14号的中餐）

B类：（学生）1500人民币元/人（同上）

C类：3800人民币元/人（高级标准间1床位，2人合住，含会议资料、8月12-14日的中餐，11、12、13日的晚餐和住宿）

D类：4600人民币元/人（高级标准间或单人间，单住，其它同上）

注：选择A C D类并在2015年 6月30日前付款的参会代表享受280元优惠。

